



## Universeller automatischer Bonder & Tester 5600Ci

### Bond / Test System

**Testköpfe** Pullköpfe – 100 cN – 5000 cN  
Shearköpfe – 500 cN – 5000 cN

**Bondköpfe** 10i, 30i, 32i, 50i, 50iHR

### Maschinen Basis

#### Achsen

- Arbeitsbereich X/Y-Achse 100 x 100 mm
- Schrittauflösung 1 µm programmierbar
- Programmierbare Z-Achse mit 60 mm Hub

#### Hardware

- Dual-Core PC mit Windows OS Ethernet,
- USB 2.0/3.0, LCD Farbdisplay 22"
- GigE-CMOS-Farbkamera
- Netzwerkfähig mit Programm-Archivierung

#### Software

- Autom. Wiederholmessung an Hybriden oder COB durch programmierbaren X/Y Kreuztisch und 360° P-Achse
- Statistik nach Mittelwert, Standardabweichung, Trend, cp, cpk auf Basis von SQL-Datenbanken
- Optionale Bilderkennung
- automatische Berechnung der realen Pullkräfte an den Bondstellen für normkonforme Tests

#### Geschwindigkeit

- 1 Draht / 2 - 3 Sekunden

#### Messgenauigkeit

- 0,1 % über den gesamten Messbereich

**Abmessung** B x T x H – 70 x 65 x 70 cm, Gewicht ca. 75 kg

**Anschlüsse** 100-240 VAC, 1 Phase, 50/60 Hz, max 500 VA  
Ø 6mm Standard-Vakuumschlauch

### Die 5600Ci:

Der vollautomatische Bondtester 5600Ci mit Kamera fügt sich hervorragend in das Geräteprogramm von F&S BONDTEC rund ums Die- und Drahtbonds ein.

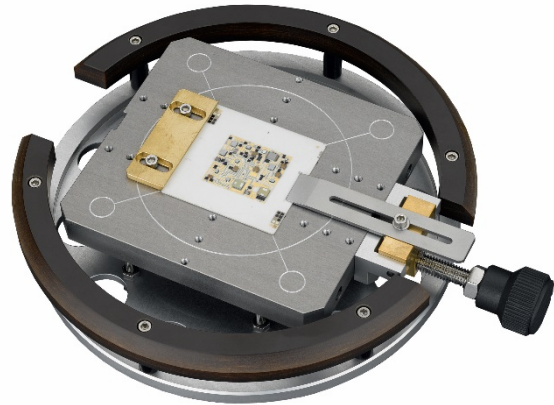
Nach der Erstellung eines Testprogrammes und dem durch eine Bilderkennung (PRU) unterstützten Adjusten, wird ein reproduzierbares und benutzerunabhängiges Pullen oder Shearen auf allen erdenklichen Bauteilen gewährleistet.

Dieser Prozess ist weltweit einzigartig und wird nur von F&S BONDTEC Semiconductor GmbH angeboten. Er ist voll PC gesteuert und kann mit seinem programmierbaren Kreuztisch zum automatischen Testen beliebig vieler Bonds eingesetzt werden. Die Testergebnisse werden je nach Wahl direkt analysiert und ausgegeben, oder direkt in eine kundenspezifische Datenbank exportiert.

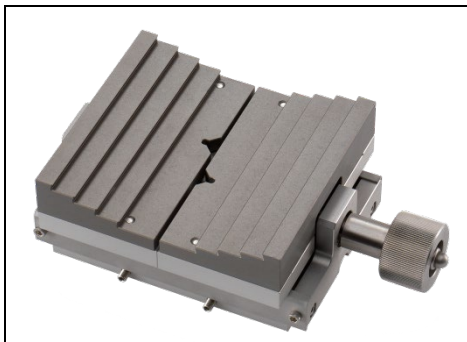
Ein besonderer Vorteil des 5600Ci sind zusätzliche Messverfahren wie der Verlauf von Kraft/Zeit, die optimalen Aufschluss über den Verlauf der getesteten Bonds geben. Die wechselbaren Messköpfe machen den Pulltester flexibel für unterschiedliche Kraftbereiche; weitere Köpfe für Pull-, Shear-, und Tweezertests mit kundenspezifischen Tools und Klemmbacken sind verfügbar.

## Substrathalter

Standard-Substrataufnahme  
für Bauteile bis 4x4" mit  
Vakuum und mechanischer Klemmung



## Optional:



für Bauteile bis 4x4"  
mit Stufenbacken



TO Aufnahme mit  
mechanischer Klemmung



4x4" Substrataufnahme m.  
gummierter Oberfläche, mit  
mechanischer Klemmung

### F&S Bondtec Semiconductor GmbH

Industriezeile 49a

A-5280 Braunau am Inn

Tel.: +43-7722-67052-8270

Fax: +43-7722-67052-8272

Mail: [info@fsbondtec.at](mailto:info@fsbondtec.at)

Web: [www.fsbondtec.at](http://www.fsbondtec.at)

